

## 导热相变化材料 XK-C15

### 简介:

XK-C 是含高分子蜡的导热相变化材料,具有高温液化成高黏度性质,有别于传统材料在高温下有外溢现象,材料有高信赖度,高导热性质

### 特性:

低热阻

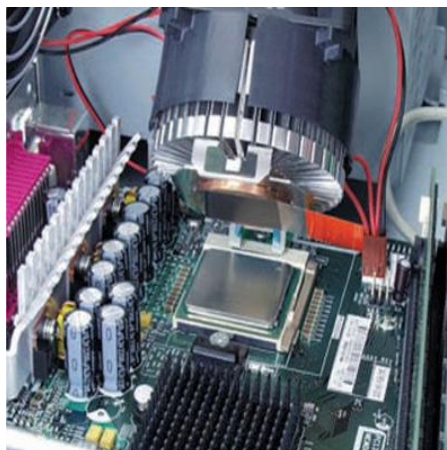
高温下为高黏度材料

低温下微黏表面, 容易操作

### 应用:

处理器

显示芯片



可对应贝格斯 HI-FLOW 200G.

	unit	XK-C15	Method
Reinforcement Carrier		Fiberglass	
Filler type		Ceramic	
Color		White	visual
Thickness	mm	0.1	ASTM D374
Specific Gravity	g/cm <sup>3</sup>	2.3	ASTM D792
Thermal impedance	°Cin <sup>2</sup> /W	0.12	ASTM D5470
Thermal Conductivity	W/mK	1.5	HOT DISK
Volume Resistivity	Ωcm	>10 <sup>13</sup>	ASTM D257
Breakdown Voltage	KV	NA	ASTM D149
Dielectric Constant	1	NA	ASTM D150
Application temperature	°C	-20~130	
Storage temperature	°C	<23	
Phase change temperature	°C	60	
Siloxane Volatiles D4~D20	%	0	GC-FID